

2003年3月期決算について

1. 企業集団の状況

(2003年3月31日現在)

主な製品・サービス	主要な連結子会社の位置付け	
	製 造	販 売・サービ ス
情報通信システム システムインテグレーション、ソフトウェア、磁気ディスク装置、サーバ、汎用コンピュータ、パソコン、コンピュータ周辺装置、交換機、通信用光部品	日立コミュニケーションテクノロジー、HITACHI COMPUTER PRODUCTS (AMERICA)、HITACHI COMPUTER PRODUCTS (ASIA)、HITACHI COMPUTER PRODUCTS (EUROPE)	日立電子サービス、日立情報システムズ[東1]、日立ソフトウェアエンジニアリング[東1]、日立システムアンドサービス、HITACHI DATA SYSTEMS HOLDING、HITACHI GLOBAL STORAGE TECHNOLOGIES NETHERLANDS
電子デバイス システムLSI、メモリ、汎用半導体、液晶ディスプレイ、半導体製造装置、計測・分析装置、医療機器	東日本セミコンダクタテクノロジーズ、日立ディスプレイズ、日立電子エンジニアリング、日立ハイテクノロジーズ[東1/大1]、日立メディコ[東1]、北日本セミコンダクタテクノロジーズ、トレセンティテクノロジーズ、HITACHI ELECTRONIC DEVICES (USA)、HITACHI NIPPON STEEL SEMICONDUCTOR SINGAPORE、HITACHI SEMICONDUCTOR (EUROPE)、HITACHI SEMICONDUCTOR (MALAYSIA)	日立セミコンデバイス、HITACHI SEMICONDUCTOR (AMERICA)
電力・産業システム 原子力発電機器、火力発電機器、水力発電機器、産業用機械・プラント、空調装置、建設機械、車両、エレベーター、エスカレーター、自動車用機器、環境関連機器	パブコック日立、日立空調システム、日立建機[東1/大1]、日立産機システム、日立インダストリイズ、日立機電工業[東1/大1]、日立ユニシアオートモティブ、日立ピアメカニクス、日本サーボ[東2]、HITACHI AUTOMOTIVE PRODUCTS (USA)、台湾日立	日立ビルシステム、日立エンジニアリング、日立エンジニアリングサービス、日立プラント建設[東1/大1]
デジタルメディア・民生機器 光ストレージドライブ、テレビ、携帯電話、液晶プロジェクタ、エアコン、冷蔵庫、洗濯機、照明器具、調理器具、電池、情報記録媒体	日立ホーム・アンド・ライフ・ソリューション、日立マクセル[東1/大1]、日立メディアエレクトロニクス、HITACHI HOME ELECTRONICS (AMERICA)、上海日立家用电器	
高機能材料 電線、ケーブル、伸銅品、鋳鉄品、鋳鋼品、高級特殊鋼、磁性材料、化学素材、電気絶縁材料、合成樹脂、炭素製品、プリント基板、セラミックス材料	日立電線[東1/大1]、日立化成工業[東1/大1]、日立金属[東1/大1]	
物流及びサービス他 電気・電子機器の販売、貨物輸送、不動産の管理・売買・賃貸		中央商事、日立ライフ、日立モバイル[東2]、日立物流[東1]、日京クリエイト、HITACHI AMERICA、HITACHI ASIA、日立(中国)、HITACHI EUROPE
金融サービス 提携ローン販売、リース、生命・損害保険代理業		日立キャピタル[東1]、日立保険サービス

(注)1. (株)東日本セミコンダクタテクノロジーズ、(株)日立セミコンデバイス、(株)北日本セミコンダクタテクノロジーズ、トレセンティテクノロジーズ(株)、HITACHI SEMICONDUCTOR (AMERICA) INC.、HITACHI SEMICONDUCTOR (EUROPE) GMBH及びHITACHI SEMICONDUCTOR (MALAYSIA) SDN. BHD.は、2003年4月1日付で、当会社の半導体事業に係る会社分割により新たに設立された(株)ルネサステクノロジ(持分法適用会社)の子会社になりました。また、同日付で、(株)東日本セミコンダクタテクノロジーズは(株)ルネサス東日本セミコンダクタに、(株)日立セミコンデバイスは(株)ルネサス販売に、(株)北日本セミコンダクタテクノロジーズは(株)ルネサス北日本セミコンダクタに、HITACHI SEMICONDUCTOR (AMERICA) INC.はRENEASAS TECHNOLOGY AMERICA, INC.に、HITACHI SEMICONDUCTOR (EUROPE) GMBHはRENEASAS SEMICONDUCTOR EUROPE (LANDSHUT) GMBHに、HITACHI SEMICONDUCTOR (MALAYSIA) SDN. BHD.はRENEASAS SEMICONDUCTOR (MALAYSIA) SDN. BHD.にそれぞれ商号を変更しました。

2. []内には株式を上場している市場を記載しています。(東1：東証1部、東2：東証2部、大1：大証1部)

2. 経営方針

当グループは、関係会社(子会社及び関連会社)各企業の発展により事業を拡大してきましたが、グローバルな市場競争が激化し日本経済が低迷する中で、グループ全体の効率向上の観点から事業の見直し、再編を図り、一層の発展を遂げることを目指しています。なかでも資本効率を高め、日立製作所の時価総額の増大を推進することにより、株主価値の向上を図ることを基本方針としています。

こうした基本方針のもと、当社は1999年11月に中期経営計画「i.e.HITACHIプラン」を策定し、お客様の課題解決に貢献していく「ベスト・ソリューション・パートナー」への変革を目指し、“ITと知で装備された「情報システムサービス」と「社会インフラシステム」、及びそれらを支える「基幹のハードウェア、ソフトウェア、高機能材料」を提供し、この分野でトータルソリューションを提供出来るグローバルサプライヤー”へと事業構造改革を進めてきました。

当社は、この基本的な考えをさらに推し進めるために、先のプランでの反省も含め、2003年1月に、新中期経営計画「i.e.HITACHIプラン」を策定しました。2005年度に向けた3年間を、高収益事業への転換を図る期間と位置づけ、売上高にして約2割の既存事業からの撤退に加え、当グループの技術・知識の強みを活かした注力分野の成長や新事業の創出により、事業ポートフォリオの組替えを行います。事業ポートフォリオの組替えにあたっての撤退、強化、育成の判断は、事業毎の将来キャッシュフロー予測に基づき、資本コストをベースとする当社独自の付加価値指標「FIV (Future Inspiration Value)」によって行います。

「情報システムサービス」と「社会インフラシステム」をさらに強化・融合していく「新時代のライフラインを支えるソリューション」の分野と、当グループの高い技術・知識を集約した競争力あるハードやソフトを中心に、グローバル市場での高成長を目指す「高度技術グローバル製品」の両分野を中核とする事業構造へ転換することで、高収益体制を確立し、当グループの成長戦略を新たな段階へと進めていきます。

この「i.e.HITACHIプラン」の実行により、2005年度においては、売上規模についてはほぼ現状規模を想定していますが、高収益事業構造への「質の転換」により、収益についてはFIVの黒字化を実現します。このために、営業利益率5%以上、ROE8%以上を達成すべく、さまざまな施策を実行していきます。また、財務体質の強化等を進め、長期債A格の維持を図ります。

さらに、個々の投資の判断においても、FIVを用いて真に株主の価値の増大に貢献する投資案件を厳選して資本を投下する方針です。あわせて売掛債権や棚卸資産をはじめとする資産の圧縮を強力に進め、総資産利益率の向上を図っています。

また、グループ内でブランドを連結経営時代の競争力を支える重要な経営資源として位置づけ、その強化を図るためにブランドマネジメントを推進しています。

当社では、事業を的確かつ迅速に運営できる執行体制の確立と透明性の高い経営を実現すべく、コーポレートガバナンスの強化に努めています。このため、取締役の数を削減し、事業部門に大幅に権限を委譲するとともに、経営全般に対して社外の有識者から助言を得る「経営諮問委員会」を設置するなどの改革を進めてきました。本年6月からは、経営上の意思決定のさらなる迅速化と経営監督の実効性の向上を図るため、委員会等設置会社に移行し、4名の社外取締役を招聘する予定です。また、当グループの上場会社18社も委員会等設置会社に移行するとともに、当社の取締役等がグループ会社の社外取締役を兼務し、グループ会社の取締役が当社取締役に就任することにより、グループ全体としての一体的な経営を推進していきます。加えて、法令順守の徹底を図るため、当社では、「コンプライアンス本部」と社外メンバーによる「アドバイザー委員会」を設置しています。

利益配分については、株主に対する配当の安定的な成長とともに、市場競争力の維持や収益の向上に不可欠な設備投資、研究開発等を実行するための内部資金の確保を念頭に、財政状態、利益水準及び配当性向等を総合的に勘案することとしています。

株式の投資単位については、資本政策の根幹をなすものとして、当社株式の市場での流通状況や当社の株主構成等を踏まえ、慎重に検討すべき問題であると認識しています。現在のところ当社株式の流動性は十分に確保されているため、投資単位の変更に伴うコストを正当化する効果を望むことは困難であると思われる。当社としては、適切な投資単位の設定について、今後も引き続き検討を行ってまいります。

3. 経営成績及び財政状態

経営成績

[2003年3月期連結決算の概要]

当期においては、世界経済は、米国、アジアを中心に回復傾向がみられたものの、後半には、牽引役の米国経済の減速、イラク情勢や株安等の先行き不透明感の高まりにより、緩やかな回復にとどまりました。一方、日本経済は、個人消費が底堅く推移し、民間設備投資が回復傾向を示す動きなどが見られたものの、世界経済の回復力が弱まる中で、景気牽引役であった輸出が勢いを失い、不良債権問題等構造的課題が未解決の状況のなかで本格的回復には至りませんでした。

このような状況下、当期における当社の連結ベースの売上高は前期比2%増の8兆1,917億円となりました。一方、営業損益については、前期から実施している調達リニューアルプロジェクトなどのCII(コーポレート・イノベーション・イニシアチブ)の効果に加え、前期に実施した事業構造改善施策による固定費削減効果等もあり、前期の1,174億円の営業損失から当期は1,529億円の営業利益となりました。

当期における部門別の売上高、営業損益については、次のとおりです。

情報通信システム部門の売上高は、世界的にIT不況からの回復が遅れるなど厳しい市場環境となりましたが、RAIDシステムやハードディスクドライブが好調に推移し、国内市場における電子行政関連などのシステムインテグレーションが堅調に推移し、前期比4%増の1兆8,996億円となりました。

営業損益については、前期から実施している通信機器事業を中心とした事業構造改善施策の効果に加え、RAIDシステムやシステムインテグレーションの増益により、全体では前期比209%増の1,105億円の営業利益となりました。

電子デバイス部門の売上高は、半導体については、システムメモリとDRAMは厳しかったものの、LCDドライバや自動車向けマイコンなどのシステムLSIと汎用半導体が好調で、半導体全体では前期を大きく上回りました。ディスプレイに関しては、携帯電話を中心に中小型TFT液晶が大きく伸長したものの、前期のパソコンモニター用ブラウン管等からの事業撤退分の減少に加え、価格下落の影響で大型TFT液晶も減収となり、全体としてほぼ前期並となりました。一方、半導体製造装置は、需要が本格的回復には至らず、低迷しましたが、部門全体では前期比6%増の1兆5,700億円となりました。

営業損益については、前期のパソコンモニター用ブラウン管等の不採算製品からの撤退や半導体における拠点集約などの事業構造改善施策の効果が現れ、前期の1,636億円の営業損失から1,403億円改善し、232億円の営業損失となりました。

電力・産業システム部門の売上高は、国内電力会社向け原子力・火力プラントの予防保全案件の減少や、民間設備投資の落ち込みを反映して空調機器、産業機器などの売上が減少したものの、2002年10月に(株)ユニシアジェックス(現:日立ユニシアオートモティブ)を完全子会社化したことにより自動車機器事業が大幅な増収となったほか、建設機械事業が中国等海外市場で好調だったこと等により、部門全体では前期比1%増の2兆2,970億円となりました。

営業損益については、建設機械事業が大幅に利益を改善したものの、電力設備などの輸出品を中心とした大口案件や国内の環境プラントの収支の悪化等の影響で、部門全体では前期比3%減の532億円の営業利益となりました。

デジタルメディア・民生機器部門の売上高は、国内市場における価格下落の影響を受けて白物家電が低迷したほか、携帯電話も売上を落としましたが、光ディスクドライブやプラズマテレビが伸長しました。日立マクセルは、オーディオ・ビデオテープは減少したものの、記録型DVDディスクや携帯電話用リチウムイオン電池などの二次電池が伸長した結果、ほぼ前期並となりました。この結果、部門全体では前期比3%増の1兆2,055億円となりました。

営業損益については、白物家電を中心とした価格下落の影響や、携帯電話の新機種投入が遅れた影響等があったものの、事業構造改善施策の効果や日立マクセルの電池事業の収益改善もあり、全体としては

前期の146億円の営業損失から208億円改善し、62億円の営業利益となりました。

高機能材料部門の売上高は、日立電線は、国内の情報ネットワーク関連製品等の伸長はあったものの、光海底ケーブルなどの電線ケーブル事業の不振により前期を下回りました。また日立金属は、自動車関連やエレクトロニクス関連製品は好調に推移したものの、設備・建築部材が振るわず、前期比横ばいとなりました。日立化成は、住宅機器・環境設備が減少したものの、半導体・液晶材料などのエレクトロニクス関連製品および工業材料関連製品が伸長し、前期を上回りました。これらにより部門全体では前期比横ばいの1兆2,485億円となりました。

営業損益については、事業構造改善施策の効果もあり、前期の220億円の営業損失から403億円改善し、183億円の営業利益となりました。

物流及びサービス他部門では、売上高は、2001年度下期に日立物流の子会社であった東京モノレール(株)を売却したことによる減少がありましたが、海外販売会社でハードディスクドライブ等が伸長したことにより、前期比1%増の1兆4,495億円となりました。

営業損益については、前期比218%増の103億円の営業利益となりました。

金融サービス部門では、中核事業であるファイナンス事業が低迷したものの、2001年度下期に日立キャピタルが積水リース(株)を買収したことによる影響もあり、売上高は前期比2%増の5,792億円となりました。

営業損益については、金利低下によるリース事業の収益悪化に加え、年金制度改訂などの財務体質健全化のための一時的な損失を計上したことにより、前期比68%減の120億円の営業利益となりました。

営業外収益については、不動産売却益等を計上したこともあり、前期に比べて106億円増加し

467億円となりました。他方、営業外費用については、前期に計上していた事業構造改善費用が当期は無くなったことと、有利子負債削減等により支払利息が減少したことにより、前期比4,018億円減の1,028億円となりました。

これらの結果、税引前当期純利益は968億円となり、法人税等526億円を差し引いた少数株主持分控除前利益が441億円、当期純利益は278億円となりました。

財政状態

キャッシュ・フローについては、営業活動に関するキャッシュ・フローは、Cプロジェクトの推進により売掛債権と棚卸資産の手持ち日数を短縮するなど、運転資本の効率向上に努めた結果、前期比1,636億円増加し、6,465億円の収入となりました。

投資活動に関するキャッシュ・フローは、投資案件の厳選による設備投資関連支出の減少と投資有価証券及び子会社株式の売却があったものの、IBM Corporationからのハードディスクドライブ事業買収等により、合計では前期比3,464億円支出が増加し、6,192億円の支出となりました。

これにより、営業活動に関するキャッシュ・フローと投資活動に関するキャッシュ・フローを合計したフリー・キャッシュ・フローは、前期比1,827億円支出が増加し、272億円の収入となりました。

また、財務活動に関するキャッシュ・フローは、コミットメントライン設定に伴い短期借入金の一部を返済したこともあり、前期比3,709億円減の2,071億円の支出となりました。

これらの結果、現金及び現金等価物は当期中に2,012億円減少し8,281億円となりました。

また、有利子負債については前期末比1,576億円減少の2兆8,405億円となりました。

設備投資額(完成ベース)は前期比8%減の7,874億円、減価償却費は前期比9%減の4,802億円となり、研究開発費については、前期比9%減の3,771億円(対売上高比4.6%)となりました。

2004年3月期連結決算の見通し

米国経済の減速に加え、イラク戦争後の復興関係の負担やSARS(重症急性呼吸器症候群)等の不安定要因の拡大により、世界経済は先行きの不透明感を増しており、本格的な回復は難しい状況にあります。日本経済も、個人消費、民間設備投資は依然として厳しい状況が続くことが予想され、企業を取り巻く経営環境は予断を許さない状況です。

こうした中で、当社は、新中期経営計画「i.e.HITACHIプラン」のもと、日立グループ内の経営資源のシナジー活用による新事業創出と注力事業の強化を進め、高収益事業への構造改革、財務体質の強化等を図っていきます。

これにより、2004年3月期の業績については下記を見込んでいます。なお、為替レートは120円/ドルを想定しています。(注)

売上高	80,000億円	(前期比 98%)
営業利益	1,700億円	(前期比 111%)
税引前当期純利益	1,100億円	(前期比 114%)
少数株主持分控除前利益	300億円	(前期比 68%)
当期純利益	50億円	(前期比 18%)

(注) 本資料における業績見通し等の将来予想に関する記述は、当社が現時点で合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等の結果は見通しと大きく異なることがあります。その要因のうち、主なものは以下の通りです。

- 急激な技術変化(特に情報通信システム部門及び電子デバイス部門)
- 新技術を用いた製品の開発、タイムリーな市場投入、低コスト生産を実現する当社及び子会社の能力
- 市場における製品需給の変動及び価格競争の激化(特に情報通信システム部門、電子デバイス部門及びデジタルメディア・民生機器部門)
- 為替相場変動(特に円/ドル相場)
- 資金調達環境(特に日本)
- 製品需給及び為替変動に対応する当社及び子会社の能力
- 主要市場(特に日本、米国及びアジア)における経済状況及び貿易規制等各種規制
- 自社特許の保護及び他社特許の利用の確保(特に情報通信システム部門及び電子デバイス部門)
- 製品開発等における他社との提携関係
- 日本の株式相場変動

以上